This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

05-102499

(43) Date of publication of application: 23.04.1993

(51)Int.CI.

H01L 31/00 G01J 1/02 H01L 31/08 H01L 37/02

(21) Application number: **03-257959**

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP <NTT>

(22)Date of filing:

04.10.1991

(72)Inventor: T

TAMURA YASUAKI

OWAKI JUNICHI

SHIBUKAWA ATSUSHI

(54) INFRARED RAY DETECTING ELEMENT AND INFRARED DETECTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an inexpensive and highly sensitive infrared detector, and an infrared ray detecting element used in this detector.

CONSTITUTION: An infrared detecting element 10 is composed of a transparent electrode 2 and an electrode 3 with an optical detecting material layer 1 sandwiched therebetween. The optical detecting material layer 1 is a sulfide or a selenide of alkaline earth metal elements to which one or more elements selected from the group of Eu, Ce, Mn, and Cu and one or more elements selected from the group of Sm, Bi, and Pb are added. CaS: Eu or Sm is exemplified as the optical detecting material. The infrared detector detects an infrared ray by measuring variations in electric capacity between the transparent electrode 2 and the electrode 3 so that variations in polarlzability of the optical detecting material layer resulting from the emission of an infrared ray can be detected.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.06.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2624410

Searching PAJ Page 2 of 2

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-102499

(43)公開日 平成5年(1993)4月23日

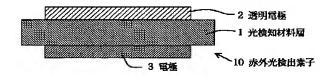
(51)Int.Cl. ⁵ H 0 1 L 31/00 G 0 1 J 1/02 H 0 1 L 31/08	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表	示箇所
	В	7381 — 2 G			
		7210-4M	H01L	31/ 00 B	
		7210-4M		31/ 08 Z	
			審査請求 未請求	対 請求項の数3(全 8 頁) 最終頁に	に続く
(21)出願番号	特願平3-257959		(71)出願人	000004226	
				日本電信電話株式会社	
(22)出顧日	平成3年(1991)10月4日			東京都千代田区内幸町一丁目1番6号	2
			(72)発明者	田村 保暁	
				東京都千代田区内幸町一丁目1番6号	子 日
				本電信電話株式会社内	
			(72)発明者	大脇 純一	
				東京都千代田区内幸町一丁目1番6月	子 日
				本電信電話株式会社内	
			(72)発明者	渋川 篤	
				東京都千代田区内幸町一丁目1番6号	} 日
				本電信電話株式会社内	
			(74)代理人	弁理士 若林 忠	

(54) 【発明の名称 】 赤外光検出素子および赤外光検出器

(57) 【要約】

【目的】 安価で感度の高い赤外光検出器と、この検出器に用いられる赤外光検出素子とを提供する。

【構成】 本発明の赤外光検出素子10は、光検知材料層 1を透明電極2と電極3とで挟持したものである。光検知材料層1は、アルカリ土類金属元素の硫化物あるいはセレン化物に、Eu, Ce, Mn, Cuの中から選択された 1 種以上の元素と、Sm, Bi, Pbの中から選択された 1 種以上の元素とをともに添加したものであり、CaS:Eu, Smが例示される。本発明の赤外光検出器は、透明電極2と電極3との間の電気容量の変化を測定することにより、赤外光が照射したことによる光検知材料層の分極率の変化を検出して赤外光を検出する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一方が透光性を有する一対の 電極と、前記電極間に挟持された光検知材料層とを有す る赤外光検出素子において、

前記光検知材料層が、アルカリ土類金属元素の硫化物あるいはセレン化物に、ユーロピウム、セリウム、マンガン、銅の中から選択された1種以上の元素と、サマリウム、ビスマス、鉛の中から選択された1種以上の元素とをともに添加したものであることを特徴とする赤外光検出素子。

【請求項2】 請求項1に記載の赤外光検出素子と、前記赤外光検出素子の電極間の電気容量を測定する電気容量測定器とからなる赤外光検出器。

【請求項3】 電気容量の測定値の時間変化を検出する 微分回路を有する、請求項2に記載の赤外線検出器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、赤外光を電気的に検出 する赤外光検出素子と、この赤外光検出素子を用いた赤 外光検出器に関する。

[0002]

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述のInGaAsを用いた半導体検出器による赤外光検出器は、非常に高価であり、また赤外光の検出感度がたかだかー60dBm程度であって微弱な赤外光を検出するには十分でないという問題点がある。

【0004】本発明の目的は、安価で感度の高い赤外光 検出器と、この検出器に用いられる赤外光検出素子とを 提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の赤外光検出素子は、少なくとも一方が透光性を有する一対の電極と、前記電極間に挟持された光検知材料層とを有する赤外光検出素子において、前記光検知材料層が、アルカリ土類金属元素の硫化物あるいはセレン化物に、ユーロピウム、セリウム、マンガン、銅の中から選択された1種以上の元素と、サマリウム、ビスマス、鉛の中から選択された1種以上の元素とをともに添加したものである。

【 0 0 0 6 】本発明の赤外光検出器は、本発明の記載の 赤外光検出素子と、前記赤外光検出素子の電極間の電気 容量を測定する電気容量測定器とからなる。

[0007]

【作用】本発明の赤外光検出素子では、光検知材料層として、アルカリ土類金属元素の硫化物あるいはセレン化物に、Eu, Ce, Mn, Cuの中から選択された1種以上の元素と、Sm, Bi, Pbの中から選択された1種以上の元素とをともに添加したものを用いているので、この光検知材料層の分極率が赤外光の照射で変化する。したがって、分極率の変化による電極間の電気容量の変化を測定することにより、赤外光を検出することができる。

【0008】これまで、化合物半導体やゲルマニウム半導体などの半導体材料を除き、1.3μm帯、1.55μm帯の赤外光に対して感度を有し光照射により分極率が変化する無機材料は知られていなかった。そこで種々の材料について実験し検討した結果、本発明者らは、アルカリ土類金属元素の硫化物あるいはセレン化物に、Eu, Ce, Mn, Cuの中から選択された1種以上の元素と、Sm, Bi, Pbの中から選択された1種以上の元素とをともに添加した材料が、赤外線に対して高い感度を有し、赤外光の照射により大きく電気容量が変化することを見出した。ここでは、硫化カルシウム(CaS)に、ユーロピウム(Eu)とサマリウム(Sm)をともに添加した光検知材料(以下CaS:Eu, Smと記載)を例に挙げて、この赤外光検出素子の動作原理を説明する

【0009】図8は、CaS:Eu, Smのパンドモデル を示す図である。この図から明らかなように、CaSの 禁制帯中で、EuとSmはそれぞれ深さの異なる不純物 準位を形成し、Euの準位は価電子帯の上端(図示V. B.) に近いところに、Smの準位は伝導帯の下端(図示 C.B.) 近くの赤外光に感度を有する程度の浅いところ に、それぞれ位置している。Smは+3価が安定な原子 価状態であるため、+2価のCaの位置に置換された場 合、正に帯電して電子に対する吸引力を有するようにな る。このためSmはある一定数のEuから電子を引抜い て電子を捕獲し、光検知材料は全体的には電気的中性を 保っている。なお、電子を引き抜かれたEuは+3価と なっている。この状態の光検知材料に赤外光を照射する と、Smの準位が赤外光に対する感度を持っているた め、Smから電子が伝導帯に放出され、放出された電子 がEuに捕獲される。この電子移動により光検知材料の 分極率が変化し、誘電率が変化して電気容量が変化す

【0010】図9はCaS:Eu,Smの赤外波長感度特性を示す図である。この図から明らかなように、CaS:Eu,Smは $0.8\sim1.7\mu$ mにわたる波長領域の赤外光に対して感度があるから、 1.3μ m帯、 1.55μ

m帯の赤外光を検出することができる。

【0011】SmからEuに遷移する電子の数は入射する赤外線の光量に比例するため、電気容量の変化分は赤外線量に比例する。したがって、電気容量の変化分を測定することにより、赤外線量を測定することができる。また、SmからEuへ遷移する電子の単位時間当たりの数は入射した赤外線の強度に比例するため、電気容量変化の時間微分値は赤外線強度に比例する。したがって電気容量変化の時間微分を測定することにより、赤外線強度を測定することができる。

【0012】ここでは、母体としてCaSを用いこれに 添加剤としてEuとSmを加えたものを光検知材料層に 使用した例で説明したが、光検知材料層はこれに限られ るものではない。アルカリ土類金属元素の硫化物あるい はセレン化物は、一般にCaSと同様のバンド構造を有 するから、母体であるCaSの代わりに使用することが できる。また、添加剤であるEuとSmとの代わりに、 これらと同様に異なる深さの不純物準位を形成し、かつ 母体中で複数の原子価状態をとり得るものであれば、添 加剤として使用することができる。Euに代わって価電 子帯の上端に近い準位を形成するものとしてCe, Mn, Cuなどがあり、またSmに代わって伝導帯の下端に近 い準位を形成するものとしてBi, Pbがある。したが って本発明では、光検知材料層として、アルカリ土類金 **属元素の硫化物あるいはセレン化物に、ユーロピウム** セリウム,マンガン,銅の中から選択された1種以上の 元素と、サマリウム、ビスマス、鉛の中から選択された 1種以上の元素とをともに添加したものを使用すること ができる。

[0013]

【実施例】次に本発明の実施例について図面を参照して 説明する。図1は本発明の赤外光検出素子の基本的な構 成例を示す模式断面図、図2は本発明の赤外光検出器の 基本的な構成例を示すブロック図、図3は微分回路を有 する本発明の赤外光検出器の基本的な構成例を示すブロック図である。

【0014】図1に示した赤外光検出素子10は、光検知材料層1を透明電極2と電極3とで挟持した構成となっている。透明電極2は少なくとも赤外光を透過する。光検知材料層1は、アルカリ土類金属元素の硫化物あるいはセレン化物に、Eu、Ce、Mn、Cuの中から選択された1種以上の元素と、Sm、Bi、Pbの中から選択された1種以上の元素とをともに添加したものでありまたれた1種以上の元素とをともに添加したものであり、これを有機材料中などに分散させたりして使用しても、これを有機材料中などに分散させたりして使用してもよい。この赤外光検出素子10を用いた赤外光の検知材工作とは、透明電極2と電極3間の電気容量の変化を測定するので、透明電極2によって行なわれる。透明電極2側から光検知材料層1の誘電率が変化するので、透明電極2と電極3間の電気容量が赤外光の照射に応じて変化す

る。

【0015】図2に示した赤外光検出器は、上述の赤外 光検出素子10と電気容量測定器4とを組み合せたもの であり、電気容量測定器4によって赤外光検出素子10 の透明電極2と電極3との間の電気容量を測定できるよ うになっている。ここで使用される電気容量測定器4と しては、各種のブリッジ回路を使用したものなど市販の ものをそのまま用いることができる。電気容量測定器4 で透明電極2と電極3間の電気容量の変化分を測定する ことにより、赤外光検出素子10が受光した赤外線量を 求めることができる。

【 0 0 1 6 】図3に示した赤外光検出器は、上述の図2で示した赤外光検出器の電気容量測定器4の出力側に微分回路5を設けたものである。赤外光検出素子10の電気容量の変化を時間微分したものは赤外線の強度となるから、微分回路5の出力には、赤外光検出素子10で受光した赤外線の強度が現れることになる。

【 O O 1 7 】次に、本発明の赤外光検出素子の実施例について、具体的数値を挙げてさらに説明する。

【0018】 [実施例1] 光検知材料層としてCaS: Eu, Sm系の材料を用いて赤外光検出素子を作製した。図4はこの実施例1で用いた赤外光検出素子の構成を示す模式断面図であり、ガラス基板11の上に、ITO(In2O3+SnO2) 透明電極12、シリコン酸化膜13、シリコン窒化膜14、CaS: Eu, Sm光検知材料層15、シリコン窒化膜14、アルミニウム電極16を順次積層した構成となっている。シリコン酸化膜13、シリコン窒化膜14を用いなくても本発明の赤外光検出素子を実現できるが、これらの膜を使用することにより、素子の安定性や信頼性が向上する。

【0019】この赤外光検出素子を作製するに当たっては、まず、NA-40ガラス基板11を純水、アセトンなどで洗浄し、スパッタ法によりこのガラス基板11の表面にITO透明電極12を200nmの厚さで形成する。次に、このガラス基板11をECR(電子サイクロン共鳴)プラズマCVD装置内に設置し、原料ガスとしてシラン10sccmを酸素10sccmを導入し、投入マイクロ波出力600Wの条件で、厚さ100nmのシリコン酸化膜13を形成した。引き続きECRプラズマCVD装置により、シラン10sccmと発って、厚さ100nmのシリコン窒化膜14を形成した。シリコン酸化膜13を設けたのは、このあとの光検知材料層15を形成する際の基板加熱によりITO透明電極12が劣化することを防ぐためである。

【0020】こののち、上述のシリコン窒化膜 1 4 までを形成したガラス基板 1 1 を真空蒸着装置内に設置し、このシリコン窒化膜 1 4 の上に厚さ 1 μ mの C a S: E u, S m光検知材料層 1 5 を形成した。この光検知材料層 1 5 は、酸化ユーロピウム(E u 2 O 3)を 2 0 0 p p

m、酸化サマリウム(Sm2O3)を200ppm添加したCaSペレットを蒸発源とし、基板温度500℃、薄膜堆積速度50nm/minの条件で、電子ピーム蒸着法により形成した。そして再びこの基板をECRプラズマCVD装置内に設置し、シリコン窒化膜14を厚さ100nmで形成し、さらにその上にアルミニウム電極16を形成し、ECRプラズマCVD装置から取り出してITO透明電極12とアルミニウム電極16にそれぞれリード線を接続して赤外光検出素子を完成させた。

【0021】このようにした形成した赤外光検出素子と電気容量測定器(検出限界1pF)とを上述の図2のように接続して赤外光検出器を構成し、赤外光を照射する前の赤外光検出素子のITO透明電極12とアルミニウム電極16との間の容量を測定したところ、1000pFであった。この状態で赤外光検出素子に赤外光を電気容量が変化し、線量1μJの赤外光の照射で500pFの容量変化を生じた。この電気容量測定器としての対したところ、線量1μJの赤外光の照射で500pFの容量変化を生じた。この電気容量測定器としての検別界は2nJということになる。また電気容量測定したといり側に微分回路を接続して赤外光の強度を測定したとり、本発明の赤外光を検出することができた。以上より、本発明の赤外光検出素子および赤外光検出器は、極めて感度が高いことが明らかになった。

【0022】 [実施例2] 表面にITO透明電極を形成した高分子フィルム22と表面に銅電極を形成した高分子フィルム23との間に、CaS:Eu,Sm粉末をフッ素ゴム中に分散させたフィルム状とした光検知材料層21を挟持し、さらに全体を透明高分子フィルム24で挟持した構成の赤外光検出素子を用いた。図5はこの赤外光検出素子の構成を示す模式断面図である。

【0023】光検知材料層21を作製するにあたっては、まず、アセトンで溶解したフッ素ゴム中にCaS: Eu, Sm材料粉末を分散させ、ITO透明電極を形成した高分子フィルム22上に塗布して乾燥させた。この光検知材料層21を塗布形成した高分子フィルム22上に、銅電極を形成した高分子フィルム23を配し、さらにこれらを2枚の透明高分子フィルム24で挟んで熱圧着し、赤外光検出素子を形成した。光検知材料層21に添加される添加物の濃度は、Euが500ppm、Smが150ppmとなるようにし、光検知材料層21の膜厚は100μmとした。

【0024】このようにした形成した赤外光検出素子と電気容量測定器(検出限界1pF)とを上述の図2のように接続して赤外光検出器を構成し、赤外光検出素子の高分子フィルム22,23のそれぞれに形成されたIT O透明電極と銅電極との間の赤外光を照射する前の容量を測定したところ、1000pFであった。この状態で赤外光検出素子に赤外光を照射したところ、照射する赤外光量によって測定される電気容量が変化し、線量1μ

Jの赤外光の照射で500pFの容量変化を生じた。電気容量測定器として検出限界が1pFのものを用いたから、赤外線量としての検出限界は2nJということになる。また電気容量測定器の出力側に微分回路を接続して赤外光の強度を測定したところ、1pWの赤外光を検出することができた。以上より、本発明の赤外光検出素子および赤外光検出器は、極めて感度が高いことが明らかになった。

【0025】 [実施例3] 実施例1ではCaS:Eu,Sm光検知材料層15をECRプラズマCVD法によって形成しているが、ここではこの光検知材料層15をガスソースMBE(分子線エピタキシャル)法によって形成した例について説明する。

【0026】実施例1と同様にしてガラス基板11上に、ITO透明電極12、シリコン酸化膜13、シリコン窒化膜14を順次積層し、そののちこの基板をMBE装置内に設置し、厚さ1μmのCaS:Eu,Sm光検知材料層15を形成した。この光検知材料層15は、Eu濃度が500ppm、Sm濃度が150ppmとなるように別々の蒸発源に充填したCa金属、Eu金属、Sm金属をそれぞれ調節して加熱蒸発させて基板面に堆積させ、さらにこれと同時に硫化水素ガスを基板面に照射することによって形成した。このときの基板温度は700℃、薄膜堆積速度は50nm/minとした。

【0027】こののち、実施例1と同様にして、光検知材料層15までが形成されたガラス基板11をECRプラズマCVD装置内に設置し、厚さ100nmのシリコン窒化膜14を形成し、さらにその上にアルミニウム電極16を形成し、ITO透明電極12とアルミニウム電極16にそれぞれリード線を接続して赤外光検出素子を完成させた

【0028】このようにした形成した赤外光検出素子と電気容量測定器(検出限界1pF)とを上述の図2のように接続して赤外光検出器を構成し、赤外光を照射する前の赤外光検出素子のITO透明電極12とアルミニウム電極16との間の容量を測定したところ、2000pFであった。この状態で赤外光検出素子に赤外光を照射したところ、照射する赤外光量によって測定される電気容量が変化し、線量1µJの赤外光の照射で1000pFの容量変化を生じた。電気容量測定器としての検出限界の容量変化を生じた。電気容量測定器としての検出限界の容量変化を生じた。電気容量測定器としての検出限界は1pFのものを用いたから、赤外線量としての検出限界は1pJということになる。また電気容量測定との機関界は1pJということになる。また電気容量測定ととしての検出することができた。以上より、本発明の赤外光を検出することができた。以上より、本発明の赤外光検出素子および赤外光検出器は、極めて感度が高いことが明らかになった。

【0029】 [実施例4] 図6はこの実施例4で用いた 赤外光検出素子の構成を示す模式断面図であり、シリコン(111) 基板31の上に、フッ化カルシウム(Ca F2) 膜32、CaS: Eu, Sm光検知材料層33、シ リコン窒化膜34、ITO透明電極35を順次積層した構成となっている。シリコン(111)基板32、フッ化カルシウム膜32、CaS:Eu,Sm光検知材料体層33をこの順に積層して形成すると、CaS:Eu,Sm光検知材料層33は単結晶膜となって膜中の欠陥が減少する。このため欠陥を経由した電子の再結合が減少し、光照射によって生じた電子が有効に分極形成に寄与して感度の高い素子が得られる。

【0030】この赤外光検出素子を作製するに当たって は、まず、シリコン基板31を沸騰した硝酸中に浸して 表面酸化膜を形成したのち純水で洗浄し、フッ化水素酸 中に浸し酸化膜を除去し表面欠陥や汚れを除去したのち 再び純水で洗浄し、塩酸、過酸化水素水、純水を3: 1:1の比率で混合した混酸中に10分間浸し良質な表 面酸化膜を形成し、さらに水洗乾燥する。そののち、こ のシリコン基板31をMBE装置内に設置し、MBE装 置内を10⁻⁸Torr以下にまで排気し、シリコン基板 31を加熱して表面酸化膜を蒸発させシリコン(11 1) 清浄表面を露出させたのち、このシリコン基板31 上に厚さ1μmのフッ化カルシウム膜32を形成した。 そして厚さ1μmのCaS:Eu,Sm光検知材料層33 を形成した。この光検知材料層33は、Eu濃度が50 Oppm、Sm濃度が150ppmとなるように別々の 蒸発源に充填したCa金属、Eu金属、Sm金属をそれ ぞれ調節して加熱蒸発させて基板面に堆積させ、さらに これと同時に硫化水素ガスを基板面に照射することによ って形成した。このときの基板温度は500℃、薄膜堆 積速度は50nm/minとした。

【0031】こののち、光検知材料層33までが形成されたシリコン基板31をECRプラズマCVD装置内に設置し、厚さ100nmのシリコン窒化膜34を形成し、さらにその上にITO透明電極35を形成し、ECRプラズマCVD装置から取り出してシリコン基板31とITO透明電極35にそれぞれリード線を接続して赤外光検出素子を完成させた。

【0032】このようにした形成した赤外光検出素子と電気容量測定器(検出限界1pF)とを上述の図2のように接続して赤外光検出器を構成し、赤外光を照射する前の赤外光検出素子のシリコン基板31とITO透明電極35との間の容量を測定したところ、1000pFであった。この状態で赤外光検出素子に赤外光を照射したところ、照射する赤外光量によって測定される電気容量が変化し、線量100nJの赤外光の照射で500pFの容量変化を生じた。電気容量測定器として検出限界が1pFのものを用いたから、赤外線量として検出限界が1pFのものを用いたから、赤外線量として検出限界は200pJということになる。また電気容量測定器の出力側に微分回路を接続して赤外光の強度を測定したところ、0.1pWの赤外光を検出することができた。以上より、本発明の赤外光検出素子および赤外光検出器は、極めて感度が高いことが明らかになった。

【0033】 [実施例5] 図7はこの実施例5で用いた赤外光検出素子の構成を示す模式断面図であり、ガリウムヒ素(111) 基板41の上に、CaS:Eu,Sm光検知材料層42、シリコン窒化膜43、ITO透明電極44を順次積層した構成となっている。ガリウムヒ素(111) 基板41とCaS:Eu,Sm光検知材料層42をこの順に積層して形成すると、ガリウムヒ素(11)とCaSとの格子定数が近いため、上述の実施例4よりもさらに欠陥の少ないCaS:Eu,Sm単結晶膜が得られ、さらに感度の高い素子が得られる。

【0034】この赤外光検出素子を作製するに当たっては、まず、ガリウムヒ素基板41を純水、トリクロロエチレンなどで洗浄し、硫化アンモニウム溶液中に浸して表面安定化処理を施し、再び純水で洗浄して乾燥させる。

【0035】次いで、MBE装置内にガリウムヒ素基板 4 1 を設置し、MBE装置内を 10-8Torr以下にま で排気しながら基板を300℃にまで加熱しつつ硫化水 素ガスを基板に照射する。硫化水素ガスの流量はマスフ ローコントローラで調節して10sccmとし、このと きの基板位置での硫化水素分圧は7×10-6Torrで あった。10分間この状態を維持して基板表面処理を施 した後、基板温度を500℃に上げ、このガリウムヒ素 基板41上にCaS:Eu, Sm光検知材料層42を1μ mの厚さで形成した。この光検知材料層42は、Eu濃 度が500ppm、Sm濃度が150ppmとなるよう に別々の蒸発源に充填したCa金属、Eu金属、Sm金 属をそれぞれ調節して加熱蒸発させて基板面に堆積さ せ、さらにこれと同時に硫化水素ガスを基板面に照射す ることによって形成した。このときの薄膜堆積速度は5 Onm/minとした。

【0036】こののち、光検知材料層42までが形成されたガリウムヒ素基板41をECRプラズマCVD装置内に設置し、厚さ100nmのシリコン窒化膜43を形成し、さらにその上にITO透明電極44を形成し、ECRプラズマCVD装置から取り出してガリウムヒ素基板41とITO透明電極44にそれぞれリード線を接続して赤外光検出素子を完成させた。

【0037】このようにした形成した赤外光検出素子と電気容量測定器(検出限界1pF)とを上述の図2のように接続して赤外光検出器を構成し、赤外光を照射する前の赤外光検出素子のガリウムヒ素基板41とITO透明電極44との間の容量を測定したところ、1000pFであった。この状態で赤外光検出素子に赤外光を照射したところ、照射する赤外光量によって測定される電気容量が変化し、線量50nJの赤外光の照射で500pFの容量変化を生じた。電気容量測定器として検出限界が1pFのものを用いたから、赤外線量として検出限界は100pJということになる。また電気容量測定器の出力側に微分回路を接続して赤外光の強度を測定した

ところ、0.05pWの赤外光を検出することができた。以上より、本発明の赤外光検出素子および赤外光検出器は、極めて感度が高いことが明らかになった。

【〇〇38】以上の各実施例では、光検知材料層として 粉末の光検知材料を有機パインダ中に分散させたもの や、電子ビーム蒸着法、ガスソースMBE法などで製膜 した光検知材料薄膜を用いたが、この他、スパッタ法、 MO(有機金属)CVD法、CVD法などの各種薄膜形成法で作製した光検知材料層を用いた場合でも、検出感度の高い赤外光検出素子が実現できた。また、素子構成 として反射防止を目的とする層や、光検知材料層の保護 を目的とする層をさらに加えて形成した多層構造のもの においても、検出感度の高い赤外光検出素子を実現でき た。

[0039]

【発明の効果】以上説明したよう赤外光検出素子についての本発明は、光検知材料層として、アルカリ土類金属元素の硫化物あるいはセレン化物に、Eu,Ce,Mn,Cuの中から選択された1種以上の元素と、Sm,Bi,Pbの中から選択された1種以上の元素とをともに添加したものを用いることにより、安価で高感度の赤外光検出素子が得られるという効果がある。また、赤外光検出器についての本発明は、本発明の赤外光検出素子と電気容量測定器とを用いることにより、安価であって、高感度な赤外光検出器が得られるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の赤外光検出素子の基本的な構成例を示す模式断面図である。

【図2】本発明の赤外光検出器の基本的な構成例を示す ブロック図である。

【図3】微分回路を有する本発明の赤外光検出器の基本

的な構成例を示すブロック図である。

【図4】実施例1で使用された赤外光検出素子の構成を 示す模式断面図である。

【図5】実施例2で使用された赤外光検出素子の構成を 示す模式断面図である。

【図6】実施例4で使用された赤外光検出素子の構成を示す模式断面図である。

【図7】実施例5で使用された赤外光検出素子の構成を示す模式断面図である。

【図8】CaS: Eu, Smのパンドモデルを示す図であ ス

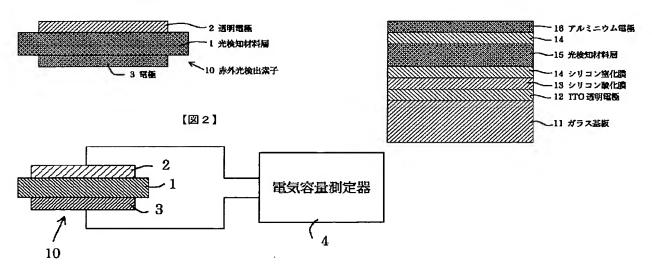
【図9】CaS:Eu,Smの赤外波長感度特性を示す特性図である。

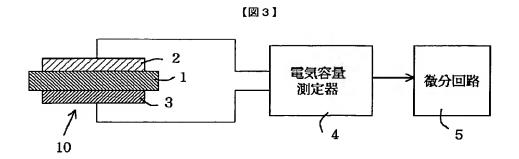
【符号の説明】

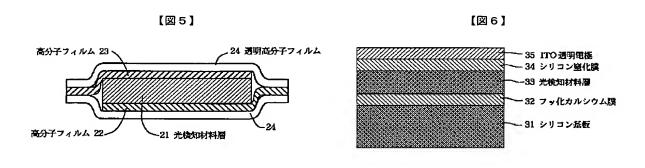
1, 15, 21, 33, 42 光検知材料層 透明電極 3 雷極 4 電気容量測定器 5 微分回路 10 赤外光検出素子 ガラス基板 1 1 ITO透明電極 12, 35, 44 シリコン酸化膜 13 シリコン窒化膜 14, 34, 43 16 アルミニウム電極 22, 23 高分子フィルム 24 透明高分子フィルム シリコン基板 3 1 フッ化カルシウム膜 32 4 1 ガリウムヒ素基板

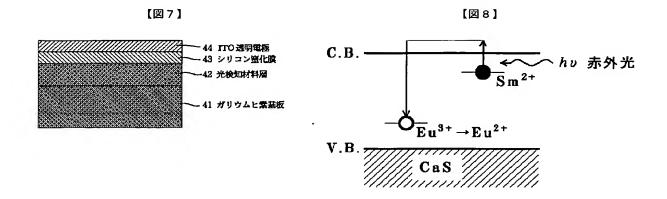
【図4】

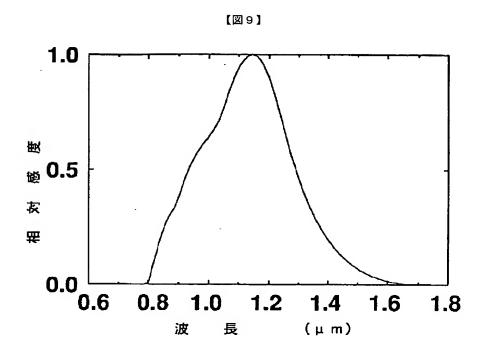
【図 1】











フロントページの続き

(51) Int. CI. 5 H O 1 L 37/02 識別記号 庁内整理番号 9276-4M FI

技術表示箇所